

3月14日暫定プログラム

会場	分野	プログラムNO	開始時間	終了時間	講演選択	発表者	所属	演題名
A	カーエレクトロニクス実装	14A1-1	10:50	11:20	依頼講演	西川 宏	大阪大学接合科学研究所	次世代パワーデバイスの実現に資する焼結型接合技術
		14A1-2	11:20	11:35	論文発表	堀川 敦	日産自動車㈱	微細プリント配線板における高温高湿環境下の信頼性
		14A1-3	11:35	11:50	論文発表	崔 時熏	名古屋大学	低誘電率材料を用いたSiCパワーモジュールの共通モードノイズ低減
		14A1-4	11:50	12:05	論文発表	松井 滉太	群馬大学大学院	ロボット芝刈り機の群制御による作業効率化
	高速高周波・電磁特性・回路技術 (1)	14A2-1	13:00	13:15	論文発表	菊地 秀雄	群馬大学大学院	移動体に安定した電力を給電する3コイルワイヤレス電力伝送システムの研究
		14A2-2	13:15	13:30	論文発表	川上 雅士	大阪工業大学	SDRを用いた電波検出システムの一検討
		14A2-3	13:30	13:45	論文発表	保坂 亮磨	九州大学大学院	無線エネルギーハーベスティング回路の開発及びBluetoothシステムの駆動実験
		14A2-4	13:45	14:00	論文発表	市川 達大	東京工芸大学	腕部表面に配置する通信用スパイラルコイルの位置ずれに対する伝送特性の検討
	高速高周波・電磁特性・回路技術 (2)	14A3-1	14:20	14:35	論文発表	伊藤 憲司	九州大学	900MHz帯金属対応小型ダイポールアンテナの設計及び評価
		14A3-2	14:35	14:50	論文発表	邱 焜祥	東京大学	コンスタレーションダイアグラムを使用したミリ波FMCWレーダーベースのリモート心拍数検出におけるアーティファクト除去方法
		14A3-3	14:50	15:05	論文発表	漆館 竜吾	東京工芸大学大学院	人体通信を用いたインタラクティブコミュニケーションシステムの検討
		14A3-4	15:05	15:20	論文発表	品川 陽斗	東京工芸大学大学院	人体通信特性の空間伝搬通信特性の優位性の検討
	高速高周波・電磁特性・回路技術 (3)	14A4-1	15:40	15:55	論文発表	金 怜	九州大学	1THz帯4レイオンチップ単方向スロットアンテナの設計および試作・評価
		14A4-2	15:55	16:10	論文発表	新地 菜央	九州大学大学院	ベイズ最適化を用いた900MHz帯単方向指向性スロットアンテナの特性向上に関する研究
		14A4-3	16:10	16:25	論文発表	SHU YIXUAN	九州大学	Design of dual band one-sided directional antenna for 5G communication
		14A4-4	16:25	16:40	論文発表	齋藤 優花	東京工芸大学	ITO透明導電膜で形成する広帯域アンテナの検討
	高速高周波・電磁特性・回路技術 (4)	14A5-1	17:00	17:15	論文発表	YI YUANTONG	九州大学	Development of slits on underground structure covers for radio wave transmission
		14A5-2	17:15	17:30	論文発表	立石 栄一	ヒノデホールディングス㈱	スマートメーター対応鋳鉄製メーターボックスの電波伝搬特性に関する研究
		14A5-3	17:30	17:45	論文発表	安陪 光紀	NTTエレクトロニクスクロステクノロジー㈱	平衡形円板共振器を用いた高周波帯域での導電率測定
		14A5-4	17:45	18:00	論文発表	元村 史龍	九州工業大学	Wavelet-OFDM通信の伝送路特性を用いた通信速度推定
B	電子部品・実装技術(1)	14B1-1	9:30	9:45	論文発表	Martinez Nora Teresa	明星大学	WBGチップAu電極とAuバンプ付き基板の低温接合におけるAr-FAB照射の効果
		14B1-2	9:45	10:00	論文発表	後藤 風輝	東北大学	ブレード法によるウエハ接合強度の評価に及ぼす測定雰囲気の影響Ⅱ (ZrO2薄膜を用いた原子拡散接合法による接合界面の評価)
		14B1-3	10:00	10:15	論文発表	家村 光	東北大学学際科学フロンティア研究所	ブレード法によるウエハ接合強度の評価に及ぼす測定雰囲気の影響Ⅰ (金属薄膜を用いた原子拡散接合法による接合界面の評価)
		14B1-4	10:15	10:30	論文発表	齊藤 丈靖	大阪公立大学	VUVによるエポキシ系樹脂の表面改質と異種界面強度の評価
	電子部品・実装技術(2)	14B2-1	10:50	11:05	論文発表	ソウ ショウウ	西日本工業大学大学院	大気圧プラズマ処理基板の保管温度がプラズマ表面改質効果の持続性に与える影響
		14B2-2	11:05	11:20	論文発表	酒井 規光	日産自動車㈱	アンダーフィルとサイドフィルによるBGAパッケージの信頼性向上
		14B2-3	11:20	11:35	論文発表	五十井 浩平	パナソニックホールディングス㈱	低荷重接合を実現する先鋭マイクロバンプ接合技術の開発
		14B2-4	11:35	11:50	論文発表	戸田 光昭	㈱メイコー	耐熱性を有するSn-Sb系高融点はんだ部品内蔵基板の実用化検討
	光回路実装技術 (1)	14B3-1	13:00	13:30	依頼講演	赤星 知幸	京セラ㈱	次世代コンピュータ配線用オンボード光電集積モジュール
		14B3-2	13:30	13:45	論文発表	高橋 美沙	京セラ㈱	マルチモードファイバアレイの高精度実装技術の開発
		14B3-3	13:45	14:00	論文発表	武藤 隆	アイオーコア㈱	超小型シリコンフォトニクス光トランシーバの液浸冷却環境におけるエラーフリー動作
	光回路実装技術 (2)	14B4-1	14:20	14:35	論文発表	高武 直弘	(株)日立製作所	ポリマー導波路搭載型光トランシーバの設計・作製と高速高密度信号伝送への応用
		14B4-2	14:35	14:50	論文発表	渡邊 明理	京都工芸繊維大学	波長多重光源の面垂直集積のための共振器集積導波モード共鳴ミラー
		14B4-3	14:50	15:05	論文発表	豊田 俊明	千葉工業大学	ホローコアファイバ用光コネクタの接続特性
		14B4-4	15:05	15:20	論文発表	大館 紅葉	東海大学	空間光通信における大気揺らぎの影響低減のためのマイクロデバイスの検討
	光回路実装技術 (3)	14B5-1	15:40	15:55	論文発表	永井 京子	古河電気工業㈱	8チャンネルCWDM TOSAを搭載したCPO用ピッグテール型QSFP ELS
		14B5-2	15:55	16:10	論文発表	吉田 航	古河電気工業㈱	Co-Packaged Optics用 56-Gb/s PAM4x8ch光トランシーバ
		14B5-3	16:10	16:25	論文発表	三浦 健輔	古河電気工業㈱	25Gbaudx16ch超小型光トランシーバを搭載したCPOドーターボードの開発
		14B5-4	16:25	16:40	論文発表	石毛 悠太	古河電気工業㈱	0.3mmピッチLGAを用いた25Gb/sx16チャンネルCPOトランシーバ用電気プラグインインターフェース
	光回路実装技術 (4)	14B6-1	17:00	17:30	依頼講演	竹崎 元人	㈱白山	2022年度光回路実装技術ロードマップの概要について
14B6-2		17:30	17:45	論文発表	藤田 巧真	三菱電機㈱	SiフォトニクスベースMach-Zehnder変調器アレイのフリップチップ実装	
14B6-3		17:45	18:00	論文発表	木下 遼太	住友ベークライト㈱	ポリマー光導波路光学特性の温度依存性	
C	ヘルスケア、ウェアラブル、バイオエレクトロニクス (1)	14C1-1	9:30	10:00	依頼講演	駒崎 友亮	産業技術総合研究所	湿度変動電池の開発とウェアラブル応用に向けた検討
		14C1-2	10:00	10:15	論文発表	伊藤 恭平	東京大学	有機系構造材と無機シリコンセンサを用いたハイブリッド傾斜センサ
		14C1-3	10:15	10:30	論文発表	安倍 慎和	東京大学	布状生体電極を用いたモーションセンサに関する研究
	ヘルスケア、ウェアラブル、バイオエレクトロニクス (2)	14C2-1	10:50	11:20	依頼講演	笠原 崇史	法政大学	マイクロ流体電気化学発光デバイスの作製と高輝度化の検討
		14C2-2	11:20	11:35	論文発表	山本 道貴	東京大学大学院	マイクロロゲート加工による縦波型圧電ストレッチャブルセンサの開発
		14C2-3	11:35	11:50	論文発表	岡崎 和伸	大阪公立大学	ウェアラブルデバイスを用いた運動時の深部体温の変動予測
		14C2-4	11:50	12:05	論文発表	小畑 裕貴	東京大学	動物の体導音計測デバイスの密閉空気室構造の検討
	マイクロメカトロニクス実装技術 (1)	14C3-1	13:00	13:15	論文発表	高倉 亮	九州大学	活性化したサファイア表面のAR-XPS分析
		14C3-2	13:15	13:30	論文発表	渡辺 要	九州大学	リン化インジウム/シリコンカーバイド常温接合界面の評価
		14C3-3	13:30	13:45	論文発表	村上 誠悟	九州大学	室温接合法により形成されたLiNbO3/Si接合界面の原子スケール解析
		14C3-4	13:45	14:00	論文発表	ZHANG GUFEI	九州大学	表面活性化室温接合法によるInP on Insulatorウエハの作製
	マイクロメカトロニクス実装技術 (2)	14C4-1	14:20	14:35	論文発表	箕輪 裕樹	東京理科大学	ゲルマニウム基板とダイヤモンド放熱基板の直接接合に関する研究
		14C4-2	14:35	14:50	論文発表	藤野 真久	産業技術総合研究所	偏極中性子反射率法によるNb接合界面の解析
		14C4-3	14:50	15:05	論文発表	若本 恵佑	ローム㈱	熱・機械サイクル負荷試験に基づく銀焼成接合劣化メカニズム
		14C4-4	15:05	15:20	論文発表	安木 大恭	京都先端科学大学	CuO/ハイブリッドナノ銀ペーストを用いた銀焼成接合体の信頼性に関する研究
	マイクロメカトロニクス実装技術 (3)	14C5-1	15:40	15:55	論文発表	田原 祐助	信州大学	マイクロ流路を用いた脂質高分子膜センサの開発
		14C5-2	15:55	16:10	論文発表	野上 大史	キュウシュウダイガク	ウシ疾病予防のための荷重付と機構一体型ストレスセンサ端末
		14C5-3	16:10	16:25	論文発表	KHOTCH ASING Kingkarn	Kyoto University of Advanced Science	将来のハイパーサーミア技術のための調整可能な発熱特性を備えた生体適合性発熱ナノ粒子の開発